

令和5年度 京都実装技術研究会 第4回例会 「はんだボイド／クラック進展と 深層学習を利用した新規解析方法」

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第4回例会として、AI・ディープラーニング技術やX線透過画像を活用したはんだ不良解析に関する講演を実施します。皆様のご参加をお待ちしております。

- ◇ 開催日時 令和6年2月9日（金） 13:30 ~ 17:00
- ◇ 開催方式 会場／Web参加 併用（講師は会場でご講演予定）
- ◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

- ◇ 内 容
「はんだボイド／クラック進展と深層学習を利用した新規解析方法」
株式会社クオルテック 植木 竜佑 様
高橋 政典 様

前半では当社が取り組んでいる AI・ディープラーニング技術を活用したはんだ不良解析方法について、X線透過画像を用いたはんだボイドの自動検出手法および、X線CTを用いたはんだクラックの3次元測定手法について紹介します。

後半では、はんだクラックの発生原因、評価方法などをお話したあと、3次元手法で測定することの意義やそこで得られた最近の研究事例を紹介します。

※講習後は懇親会も開催します（会費は研究会より補助あり）

- ◇ 定 員 会場：40名 Web：40名
- ◇ 参加費 会員：無料 非会員：10,000円
（研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円／社）
- ◇ 申込締切 令和6年2月7日（水）まで
※懇親会にご参加される場合は2月1日（木）までにお申し込みください。
- ◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和5年度 京都実装技術研究会 第4回例会申込書

「はんだボイド/クラック進展と深層学習を利用した新規解析方法」(2/9)

会社名					
所在地					
連絡担当者	所属・役職				
	氏名				
	E-mail				
	電話番号				
	参加方法	<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 連絡のみ担当 (本人は不参加)			
	懇親会	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加			
参加者	所属・役職	氏名	E-mail <small>※個別連絡も希望する場合は記入</small>	参加方法	懇親会
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
備考					

※参加申し込み締め切り 2/7 (水) まで。

懇親会へのご参加を希望される場合は2/1 (木) までにお申し込みください。

(期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります)

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1 事業所1 接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。